

**TSMC VCA 에이직랜드, 증권신고서 제출...11월 코스닥 상장 목표**

- ▶ TSMC 높은 공정 이해도기반 토탈 턴키 서비스 제공 → TSMC 고속성장 최대 수혜기업
- ▶ 상장 통해 AI반도체 및 자율주행 시장선점 및 미국시장 진출로 성장가속화 견인

<2023-09-18> 국내 유일 TSMC VCA 에이직랜드가 11월 코스닥 상장을 위한 IPO절차에 착수했다.

**ASIC(주문형반도체) 디자인 솔루션 대표기업 에이직랜드(대표 이종민)는 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 기업공개(IPO)에 돌입한다고 18일 밝혔다.**

총 공모주식수는 2,636,330주, 희망 공모가 밴드는 19,100원~21,400원으로 총 공모금액은 약 504억~564억 원 규모다. 오는 10월 23일~27일 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 11월 2일~3일 청약을 거쳐 11월 내 코스닥 상장을 목표로 한다. 대표 주관사는 삼성증권이다.

에이직랜드는 전세계 최대 파운드리 TSMC의 국내유일 VCA다.

TSMC의 선단 공정과 레거시 공정을 통한 반도체 개발 및 양산을 목표로 하는 전세계 우량 팹리스 기업이 에이직랜드의 주요 거래처다. 최근 4차산업혁명 가속화에 따른 AI반도체, 자율주행 등 최첨단 미래 반도체 시장수요가 확대됨에 따라 에이직랜드 수주량도 크게 늘었다. 여기에 CoWos 등 고부가가치 첨단 패키징 솔루션 선 확보로 엣지향 AI반도체와 오토모티브, 5G 등 4차 산업 주요 고객에게 디자인 솔루션을 전방위적으로 제공하고 있다. 최근 AI반도체 프로젝트 비중이 70%, 차량용 반도체 비중도 크게 늘고 있어 4차산업 성장 최대수혜기업으로 자리매김했다.

상장주관사인 삼성증권 관계자는 “챗 GPT 등 초고속, 고집적 AI반도체 성장이 가속화되면서 폭넓은 공정을 보유한 TSMC파운드리 선호도가 높아지고 있다” 며 “에이직랜드는 국내유일 VCA로 글로벌 시장내 TSMC VCA인 GUC, 알칩과 진검승부를 통해 세계 톱 디자인하우스로 도약할 역량이 큰 회사” 라고 강조했다.

**실제로 에이직랜드는 ▲세계 최초 고대역대 기지국용 5G RF칩 양산 ▲국내 최초 AI반도체 상용화 ▲TSMC의 다양한 전공정 레퍼런스 보유 등 독보적인 기술경쟁력을 갖췄다.** 향후 기존사업의 고도화를 토대로 TSMC, Arm 등 글로벌 메이저 파트너와의 동반성장, 4차산업 가속화에 따른 수혜 극대화, 전세계 팹리스 거대시장인 미국시장 본격진출로 지속성장을 견인할 방침이다.

이에 대해 에이직랜드 이종민 대표이사는 “금번 IPO를 통해 글로벌 팹리스의 본고장인 미국시장 진출 본격화로 TSMC VCA 대표주자로 글로벌 톱 디자인하우스로 성장할 것” 이라며 “4차 산업 가속화에 따른 프로젝트 확대, IP비즈니스 등 지속적인 성장동력 장착으로 고속성장을 견인하겠다” 고 포부를 밝혔다.

<참고자료>

[에이직랜드 IPO 일정(예정)]

증권신고서 제출	2023년 9월 15일
수요예측	2023년 10월 23일 ~ 10월 27일
청약	2023년 11월 2일 ~ 11월 3일
코스닥 상장(예정)	2023년 11월 13일

공모(예정)주식수	2,636,330주 (전량 신주)
주당공모가액	19,100원 ~ 21,400원
공모예정금액	504억 원 ~ 564억 원
상장(예정)주식수	10,597,676주
예상 시가총액	2,043억 원 ~ 2,289억 원